

品质 & 信誉 铸造 工匠精神
Quality & reputation casting craftsman spirit

苏州施密科微电子有限公司
Suzhou Semc Microelectronic Equipment Co.,Ltd.

☎ 电话: +86-512-69393266-802/808

☎ 传真: +86-512-69393266

🌐 网址: www.semctech.com

✉ 邮箱: sales@semctech.com

📍 地址: 江苏省苏州市相城区渭塘镇钻石路1979号

🕒 版本号: 20240201



施密科
SEMCTECH

BECAUSE OF OUR SPECIALTY
SO WE ARE TRUSTWORTHY
施密科微电子设备



苏州施密科微电子有限公司
Suzhou Semc Microelectronic Equipment Co.,Ltd.

目录 CONTENT

A

企业简介

苏州施密科微电子设备有限公司
SUZHOU SEMC MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.

B

产品解决方案



C

合作



ABOUT US

关于我们	01
企业定位核心价值观	03
服务领域	05
我们的实力	07
荣誉资质	09
技术保障	11



PRODUCT SOLUTIONS

产品服务	13
全自动RCA清洗机	15
全自动有机去胶清洗机	16
全自动腐蚀清洗机	17
金属刻蚀机	18
半自动SPM清洗机	19
半自动显影清洗机	20
电镀设备	21
部件清洗机	22
CDS供液系统	23
研磨液供液系统	24
碱刻洗净机	25
硅电极真空刻蚀洗净设备	26
全自动单片清洗设备	27



COLLABORATIVE

施密科服务	29
合作客户	31

ABOUT US

关于我们

苏州施密科微电子设备有限公司位于以“人间天堂”“园林之城”而闻名天下的苏州，公司成立于2017年，是一家集研发、生产、销售为一体的湿法制程设备制造商；服务于晶圆衬底材料、化合物半导体、SAW、IGBT、MEMS、先进封装等多个领域。

公司核心团队均由十年以上从业经验的行业精英组成，拥有丰富的半导体行业高端项目经验；目前我司已与国内外多家知名企业展开合作，凭借先进的研发技术、精尖的人才梯队和丰富的产品线，赢得了客户的一致好评及信赖。苏州施密科将秉承“以人为本，精益求精，品质卓越，合作共赢”的发展理念，与客户携手共进，共创未来！



定位 | POSITION

高端湿制程装备及工艺技术综合解决方案提供商



目标 | GOAL

在专业细分领域，具备顶尖技术，铸就一流品牌



愿景 | VISION

成为具有国际影响力的中国装备制造企业

Quality
品质

Professional
专业

Innovative
创新

Cooperation
合作



POSITION CORE VALUES

企业定位与核心价值

成为中国知名的
高端湿制程设备及工艺方案提供商

Become famous in China
High-end wet process equipment and process solutions provider



Professional Standard 员工职业标准

团队协作

通过高效协同，
追求团队进步

简单
真诚

永远倡导简单
真诚的人际关系

专业
敬业

以专业敬业实现
个人进步和事业成功

努力
开创

努力开创
事业未来



Organizational Success Traits 组织成功特质

创新 坚持顶天立地的创新方向和路径 **坚守** 坚韧不拔地坚守企业长期发展理想

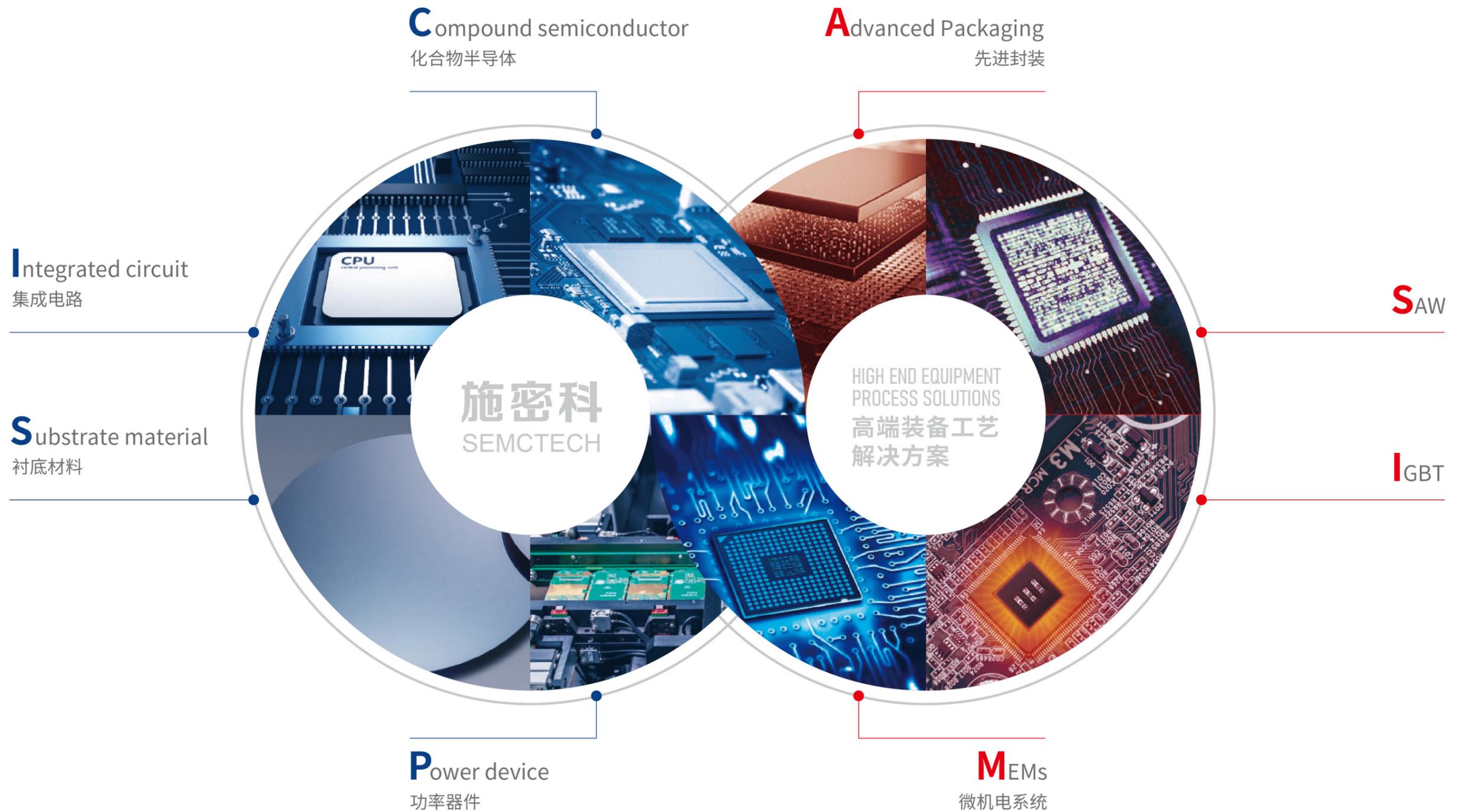


Enterprise Value Proposition 企业价值主张

成就客户 致力于客户的满意与成功

SERVICE SECTOR

我们的服务领域



STRENGTH

我们的实力



施密科将继续努力，不断提升自身的技术水平和产品质量，为客户提供更优质、更可靠的高端电子设备。

OUR HONOR

我们的荣誉

施密科多年自主研发的成果，
我们有能力成为您的完美合作伙伴，
为您提供定制化和标准化的湿制程解决方案。



OUR QUALIFICATIONS

我们的资质

我们一直在研发的路上...

5项
发明专利

18项
实用新型专利

5项
外观设计专利

23项
软件著作权



TECHNICAL SUPPORT

技术保障

我们一直遵循对每一道工序负责
对每一台产品负责
对每一位用户负责的质量方针
竭诚为用户服务



CORE TEAM 01
ONE

核心技术团队保障

02
TWO

STRATEGIC COOPERATION

龙头企业、知名学校等长期战略合作关系

复旦大学 苏州大学 太原工业学院 西湖大学

QUALITY ASSURANCE 05
FIVE

产品质量保障 多道质检程序

06
SIX

INSTALLATION TRAINING

配有专业人员安装测试及培训

03
THREE

DEVELOPMENT AND OEM

原型机开发与代工

04
FOUR

SERVICE TEAM

专业服务团队全面跟进售前、售中、售后服务

07
THREE

DELIVERY GUARANTEE

原型机开发与代工

配有专业人员安装测试及培训

08
EIGHT

SPARE PARTS SUPPORT

PRODUCT SERVICE

产品服务



H/W 设备

6" 8" AUTO BENCH
6" 8" AUTO SINGLE SPIN
6" 8" BATCH SPRAY TOOL
12" AUTO BENCH
12" AUTO SINGLE SPIN
12" BATCH SPRAY TOOL
12" FOUF CLEAN
12" MASK CLEAN
CCSS (CDS)

S/W 软件

AUTO WET BENCH
AUTO SINGLE SPIN
BATCH SPRAY TOOL
8" FOUF CLEAN
8-12" MASK CLEAN
SECS/GEN FUNCTION
SCADA

Process 制程

SOLDER PLATING
WLCSP
3D IC
GOLD BUMPING
LED
TOUCH PANEL
FRONT-END
SOLAR CELL

Consult 咨询

HYDRODYNAMICS
SIMULATION
MATERIAL
MECHANICS
CHEMISTRY

01

AUTOMATIC RCA CLEANING BENCH 全自动 RCA 清洗机



项目	数据
适应工件	6~12寸晶圆片清洗
批量产能	25/50pcs/批
工艺流程	LOAD→SPM→QDR→DHF→QDR→SC1→
工艺流程	QDR→SC2→QDR→DRYING→UNLOAD
主要材料	金属骨架+PVC/PPW壳板,槽体采用石英/PPN/PTFE材质
运送方式	机械臂传送
节拍时间	依工艺5~10min可调
工艺效果	颗粒去除率达>99%
其他说明	此设备可根据客户要求定制手动/半自动

项目	数据
适应工件	8-12寸晶圆片去胶清洗
批量产能	8~12寸13/25pcs/批
工艺流程	FOUP →EFM →去胶→IPA→QDR →QDR→DRYING→ EFM→FOUP
主要材料	SUS骨架+SUS壳板,槽体采用SUS316L石英/PVDF/PTFE材质
运送方式	机械臂传送
节拍时间	依工艺5~10min可调
工艺效果	去胶效率>99%
其他说明	此设备可根据客户要求定制手动/半自动



02

AUTOMATIC SOLVENT CLEANING BENCH 全自动有机去胶清洗机

03

AUTOMATIC WAFER CORROSIVE BENCH 全自动腐蚀清洗机



项目	数据
适应工件	6~12寸晶圆片清洗
批量产能	25pcs/批
工艺流程	LOAD → SC1 → QDR → SC2 → QDR →
工艺流程	DHF → QDR → DRYING → UNLOAD
主要材料	金属骨架+PVC/PPW壳板,槽体采用石英/PPN/PTFE材质
运送方式	机械臂传送
节拍时间	依工艺5~10min可调
工艺效果	颗粒去除率达>99%
其他说明	此设备可根据客户要求定制手动/半自动

项目	数据
适应工件	6~8寸晶圆片清洗
批量产能	8寸25PCS/批
工艺流程	Cu刻蚀→ODR→Ti刻蚀→ODR→Au刻蚀→ODR
工艺槽功能	循环过滤+加热冷却+上下抖动+花篮提升
主要材料	金属骨架+PVC/PPW壳板,槽体采用PPN/PVDF材质
运送方式	手动传送
节拍时间	依工艺5~15min可调



04

METAL ETCHING BENCH 金属刻蚀机



项目	数据
适应工件	6~8寸晶圆片清洗
批量产能	8寸25PCS/批
工艺流程	SPM→QDR(40-60°C)→QDR
工艺槽功能	循环过滤+加热冷却
主要材料	金属骨架+PVC/PPW壳板,槽体采用PPN/PVDF材质
运送方式	机械手自动前后传送
节拍时间	依工艺5~15min可调

项目	数据
适应工件	4~8寸晶圆片清洗
批量产能	8寸25PCS/批
工艺流程	QDR←显影→QDR←显影→QDR
工艺槽功能	循环过滤+加热冷却+上下抖动+硅片滚动
主要材料	金属骨架+PVC/PPW壳板,槽体采用PPN/PVDF材质
运送方式	手动传送
节拍时间	依工艺5~15min可调



07

AUTOMATIC PLATING BENCH 全自动电镀机



项目	数据
适应工件	2~12寸晶圆片电镀
批量产能	1pcs/批
工艺流程	前处理→电镀→水洗(Au Ni Cu...)
主要材料	金属骨架+PVC/PPW壳板,槽体采用PVDF/PPN材质
运送方式	手动传送
节拍时间	依工艺5~10min可调
其他说明	此设备可根据客户要求定制手动/半自动

项目	数据
适应工件	8/12寸晶圆/硅环
批量产能	10片
主要材料	金属骨架+PVC/PPW壳板,槽体采用SUS316L/PPN材质
运送方式	自动传送
节拍时间	依工艺5~30min可调
其他说明	此设备可根据客户要求定制全自动



08

PARTS CLEANING BENCH 部件清洗机

09

CDS SUPPLY SYSTEM CDS 供液系统



项目	数据
工艺流程	配液-混液-供给
主要材料	金属骨架+PP/SUS304壳板
运送方式	自动传送(酸、碱、有机)
节拍时间	依工艺5~10min可调
其他说明	此设备可根据客户要求定制

项目	数据
工艺流程	配液-混液-供给
主要材料	金属骨架+PVC/PPW壳板
运送方式	自动传送(抛光液)
节拍时间	依工艺5~10min可调
其他说明	此设备可根据客户要求定制 (自循环、浓度、温度、PH监测, 搅拌)



10

EP SLURRY SUPPLY SYSTEM 研磨液供液系统

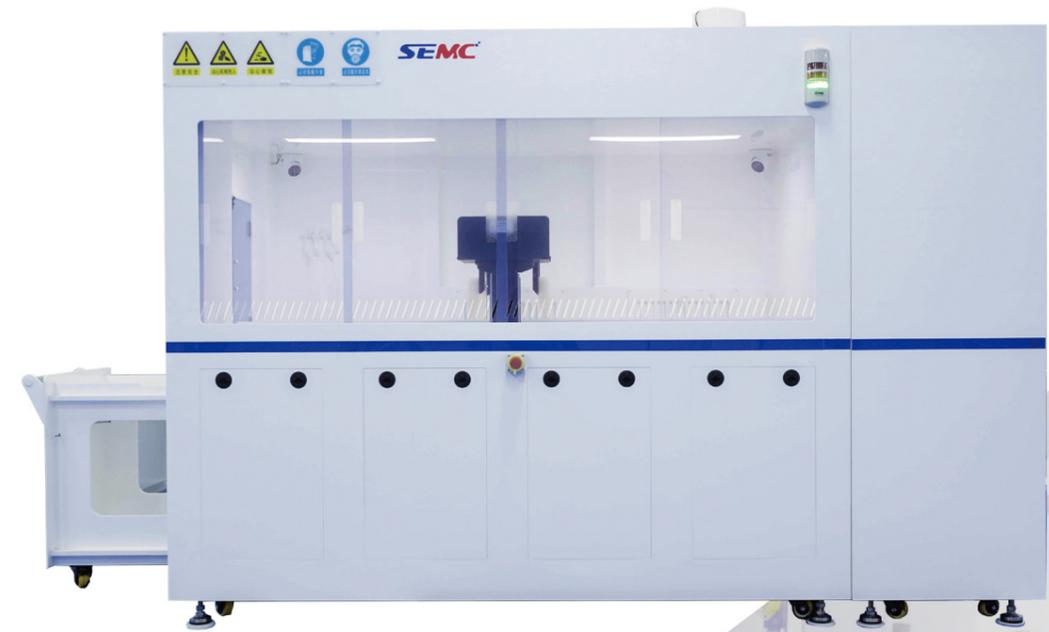
11

ALKALI ENGRAVING CLEANING BENCH 碱刻洗净机



项目	数据
适应工件	硅环直径300~650mm, 工装可调, 垂直清洗
批量产能	2PCS/批
工艺流程	水洗→碱刻→水洗→碱洗
工艺槽功能	循环过滤+加热+鼓泡+旋转
主要材料	金属骨架+PPW壳板, 槽体采用PPN/PTFE材质
运送方式	机械臂传送
节拍时间	依工艺5~15min可调

项目	数据
适应工件	硅电极直径345~600mm, 厚度10~30mm, 重量5~15KG
批量产能	1PCS/批
工艺流程	孔酸刻蚀→冲洗
工艺槽功能	循环过滤+孔冲洗刻蚀
主要材料	金属骨架+PPW壳板, 槽体采用PVDF/PPN材质
运送方式	机械臂传送
节拍时间	依工艺5~15min可调



12

SILICON ELECTRODE VACUUM ETCHING CLEANING BENCH 硅电极真空刻蚀洗净设备

SINGLE WAFER WET
CLEANING EQUIPMENT
全自动单片清洗设备



项目	数据
应用领域	RCA清洗, 沉积前清洗, 蚀刻后清洗, CMP后清洗, 湿法刻蚀, EPI前清洗等
晶圆尺寸	100MM~300MM
设备配置	4~16腔体 (可定制)
	支持2~4个CST/SMIF/FOUP上下料
	支持化学液自动供液CCSS,LCSS
	加热控制, 浓度控制, 流量控制, 压力控制等;
	酸、碱、有机液排风分离;
工艺指标	支持化学液回收;
	全面支持SECS/GEM通讯协议
	蚀刻均匀性: 片内: ≤3%; 片间: ≤3%; 批次间: ≤3%;
颗粒控制	增加值<20颗@0.2微米(带氧化硅膜测试, 来料颗粒<50颗)
金属离子	<5E9 ATOMS/CM2

PRODUCT SERVICE

产品服务

CALCULATION



Service and Support

- 施密科具备独立的售后服务团队，随时提供最专业的服务支持。
- 公司保证所提供的产品质量符合客户需求标准。
- 保修期内:自设备交付验收之日起1年。期间为设备非人为操作导致设备无法运行的非易损零部件的保养和更换。
- 保修期外:提供所有硬件,软件维护、升级及技术支持,该项服务具体包括通过电子邮箱和电话支持,软件系统的升级,以及我方工程师不定期的上门服务,并保证材料及配件以成本价供应,终生负责维修。
- 在保修期内,如设备发生问题,我方会在收到用户书面通知2小时内给予答复,36小时(除去在途时间)到达设备现场,且尽量备齐设备维修所需的零部件。
- 全年7x24小时,提供电话、传真和电子邮件免费技术咨询和技术支持。
- 客户在正常使用中出现性能故障时,我们承诺以上保修服务。除此以外,国家适用法律法规另有明确规定的,本公司将遵照相关法律法规执行。



CUSTOMER GROUP

客户群体



名片